

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月1日(01.05.2025)



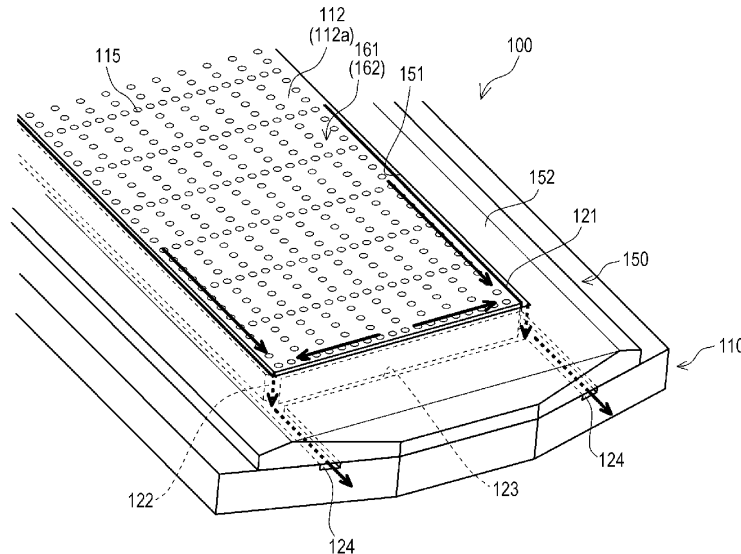
(10) 国際公開番号

WO 2025/088848 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) *B24B 41/06* (2012.01)
B23Q 3/08 (2006.01) *B24B 55/06* (2006.01)
B23Q 11/00 (2006.01) *H01L 21/683* (2006.01)
B24B 27/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/023733
- (22) 国際出願日: 2024年7月1日(01.07.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-182821 2023年10月24日(24.10.2023) JP
- (71) 出願人: T O W A 株 式 会 社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 (JP).
- (72) 発明者: 渡 辺 創 (WATANABE Hajime); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 (JP). 石橋 幹司 (ISHIBASHI Kanji); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 (JP). 高橋 和宏 (TAKAHASHI Kazuhiro); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 T O W A 株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 三上 葉子 (MIKAMI Yoko); 〒3300854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 - 2 6 6-3 J C 特許事務所 (JP).

(54) Title: SUCTION PLATE, CUTTING DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 吸着プレート、切断装置、及び、電子部品の製造方法



(57) Abstract: The present invention provides a suction plate with which it is possible to form a half-cut groove with high accuracy. Provided is a suction plate for holding an object to be cut having a substrate and a resin layer, the suction plate including: a base member that includes a base part which is disposed on a base that is provided with a suction mechanism, and a projection part which is formed so as to protrude upward from the base part and has a suction surface that is capable of sucking the resin layer; and a frame-like member that is disposed so as to surround the periphery of the projection part

[続葉有]



WO 2025/088848 A1

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

and has a mounting surface which is formed so as to be positioned above the suction surface, and on which the substrate can be mounted. At least one of the base member and the frame-like member is provided with a discharge passage through which foreign substances in a specified space that is defined by the projection part and the frame-like member can be discharged to the outside of the specified space.

(57) 要約: 高精度にハーフカット溝を形成することが可能な吸着プレートを提供する。基板及び樹脂層を有する切断対象物を保持する吸着プレートであって、吸引機構が設けられた基台上に配置される基部、及び、前記基部から上方に突出するように形成され、前記樹脂層を吸着可能な吸着面が形成された突出部を具備するベース部材と、前記突出部の周囲を囲むように配置され、前記吸着面より上方に位置するように形成された前記基板を載置可能な載置面を具備する枠状部材と、を具備し、前記ベース部材及び前記枠状部材の少なくとも一方には、前記突出部及び前記枠状部材により規定される規定空間内の異物を、前記規定空間外へと排出可能な排出通路が形成されている。